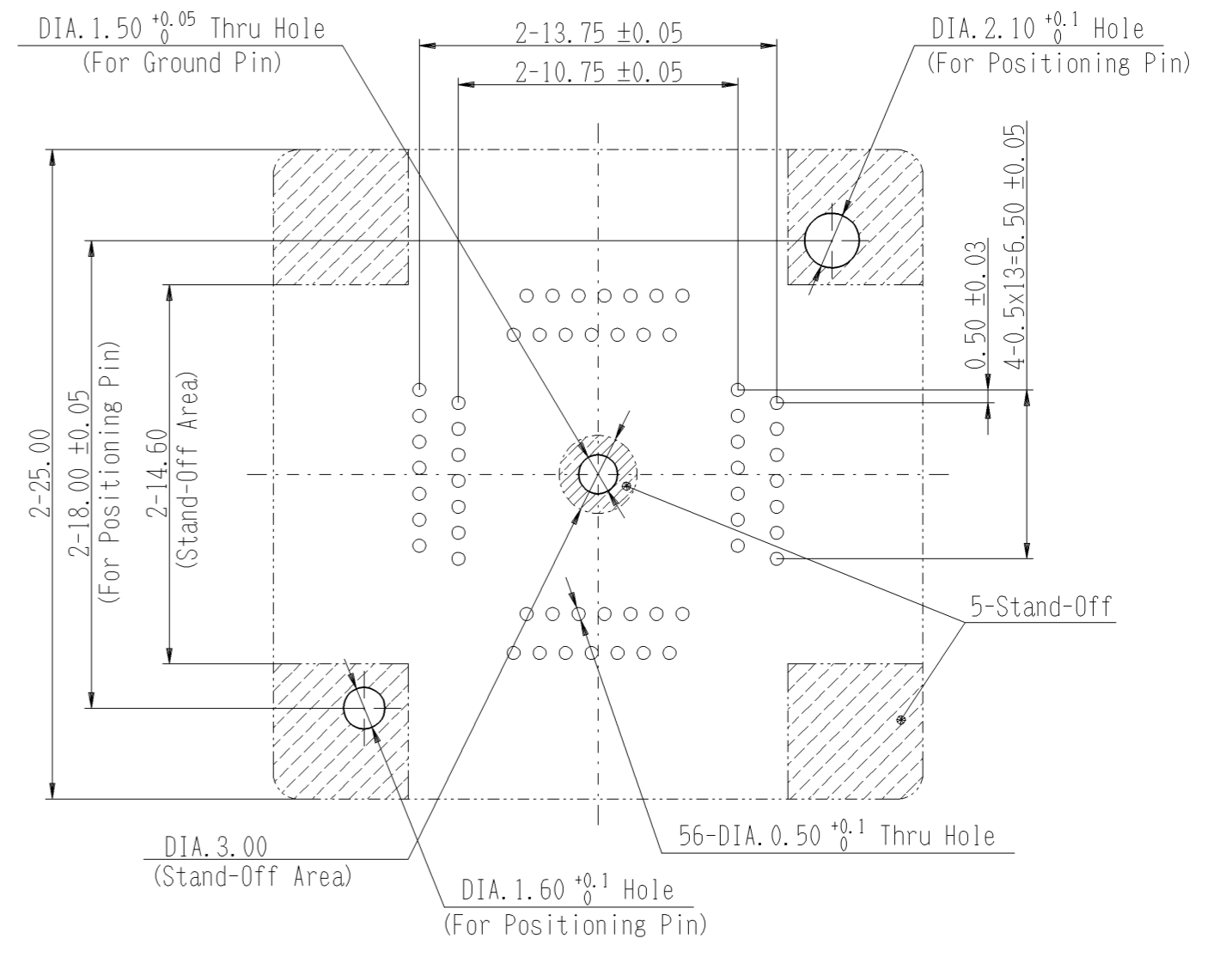
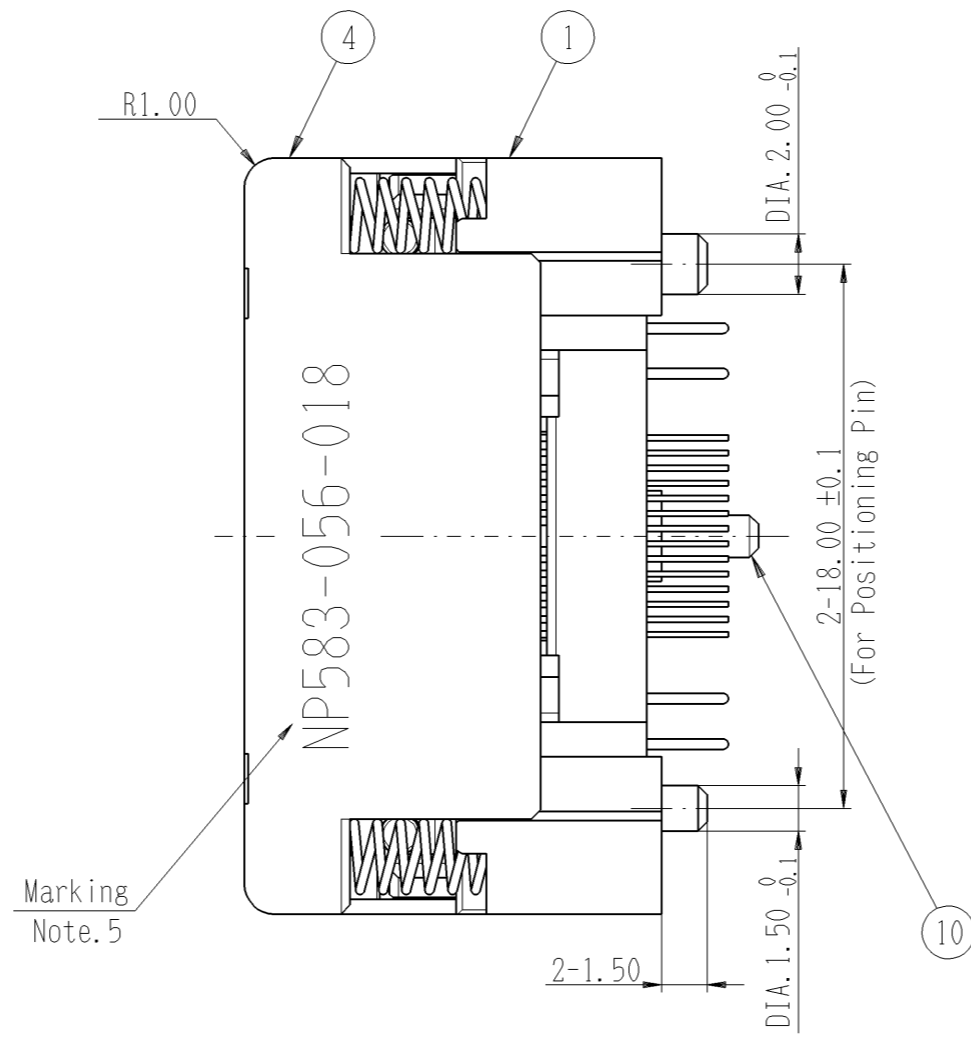
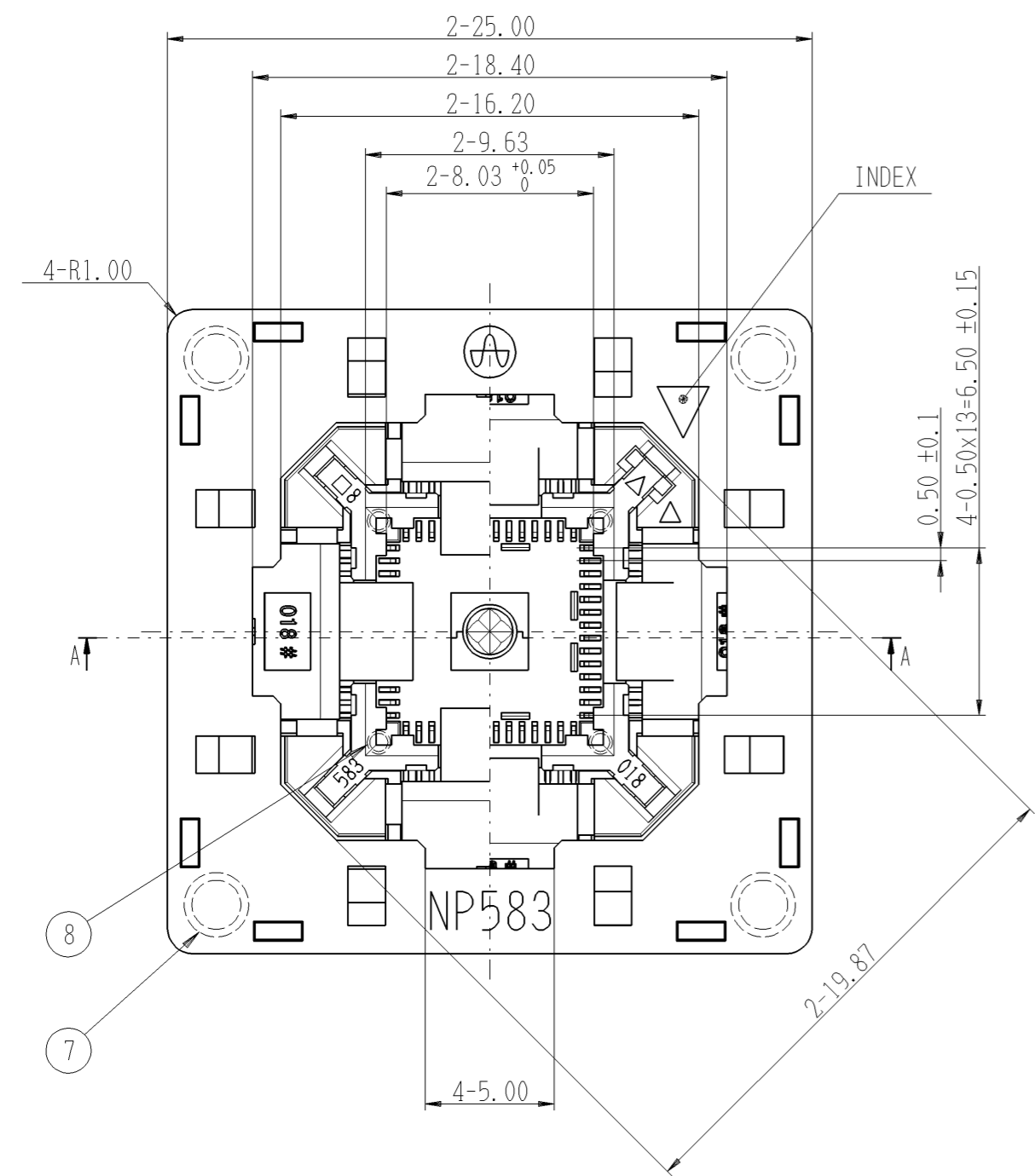
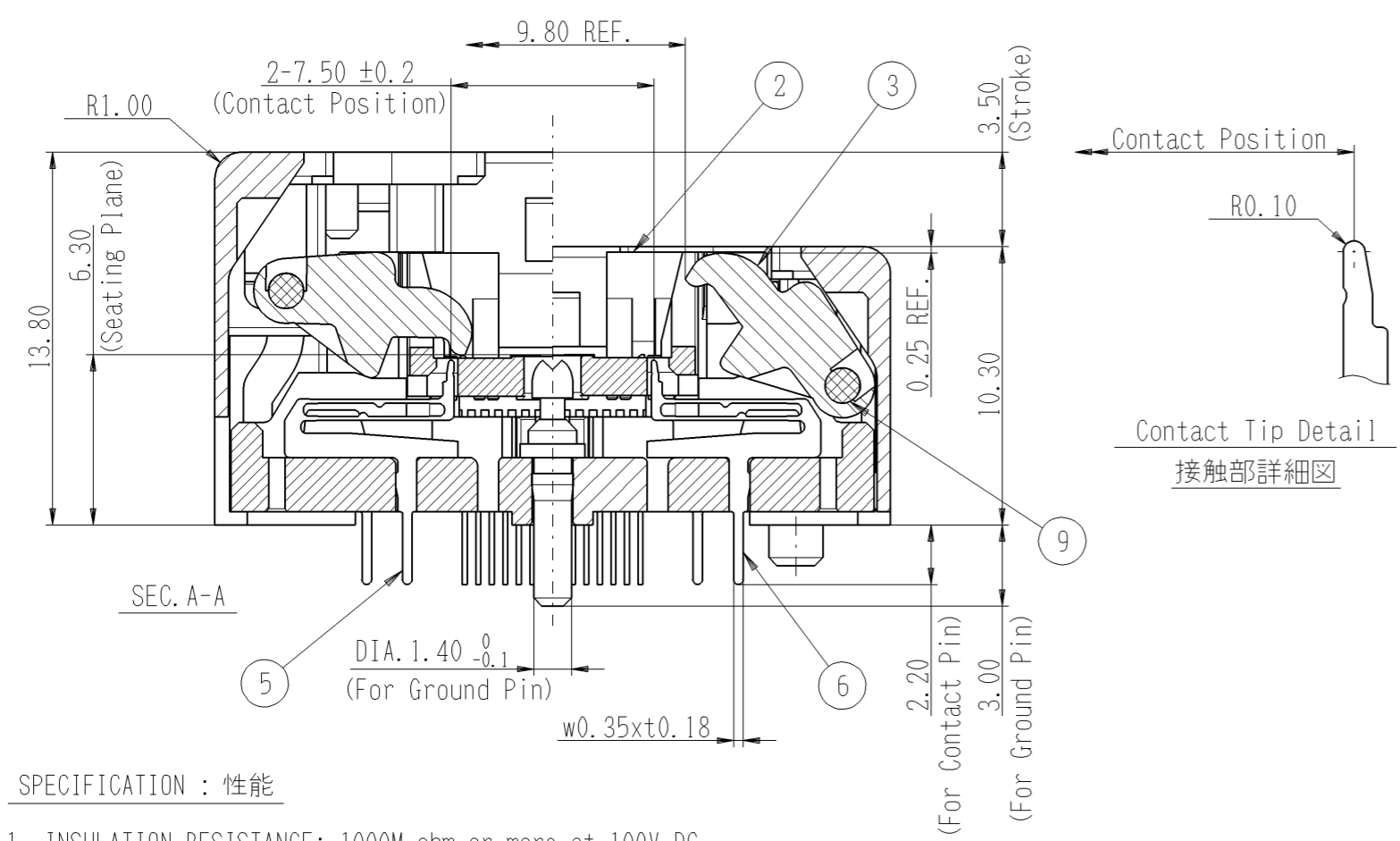


CONFIDENTIAL

記号×数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
△×							
△×							
△×							
△×							
△×							



CONTACT THROUGH HOLE PATTERN  
Pattern shown looking down through top of socket.  
プリント板穴あけ寸法図 (表面より透視)



OPERATING METHOD/操作方法

- PACKAGE INSERTION OPERATION : パッケージ挿入操作
  - Push the cover all way down until it stops then insert the package on top of floating carrier. パッケージはカバーを押し切った状態で位置決め台座上に落とし込みます。
  - To hold the IC in place, release the cover. カバーを開放することによりパッケージは位置決め台座上で嵌合状態となります。
- PACKAGE REMOVING OPERATION : パッケージ抜き操作
  - Push the cover all way down until it stops then take the package out. (when the cover is pushed down, a vacuum method can be used to pull out the package.) カバーを押し切った状態でパッケージ取り出し可能となります。(パッケージの取り出しはカバーを押し切った状態でバキューム等により行って下さい。)

NOTE : 注記

- Upon the condition that package lid surface remain parallel to insulator base. ICがソケットに正しく装着されていること。
- Keep the board trace out of the socket stand off area to avoid trace cut and socket tilting. ソケットスタンドオフエリア内の配線は避けて下さい。断線及びソケットの浮き等問題発生可能性があります。
- Cool down the assembled PC board to room temperature before the washing process. 洗浄工程の投入は、ボード及びソケットが常温になってから実施のこと。
- Mask holes on the P.W.B. to prevent solder migration. 半田上がりが発生しない様、マスキング等の処理をして下さい。
- Marking shall be done. 図で示す様に表示を行う。

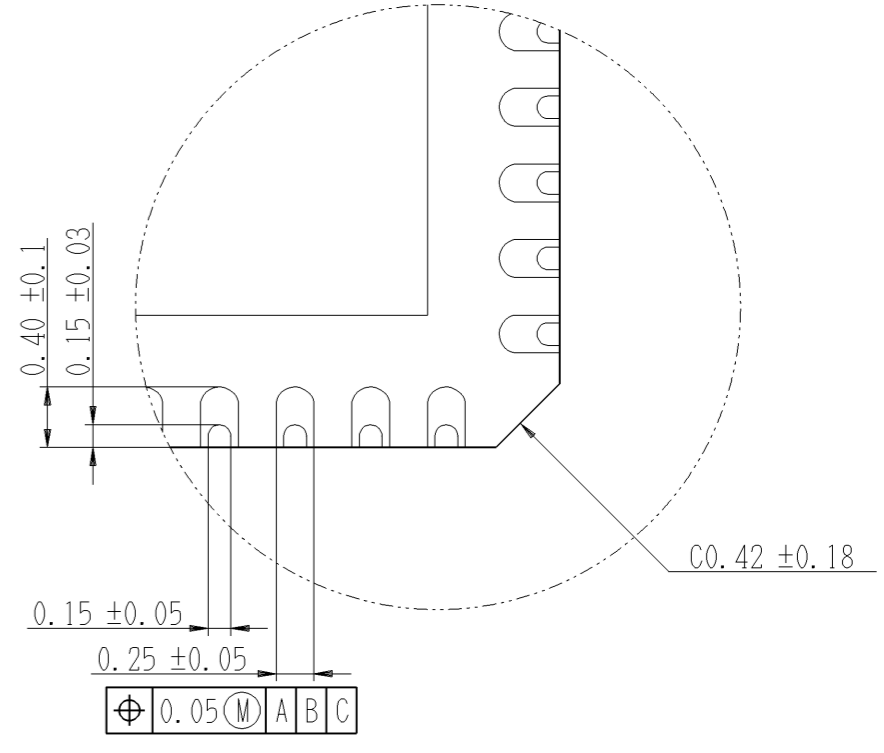
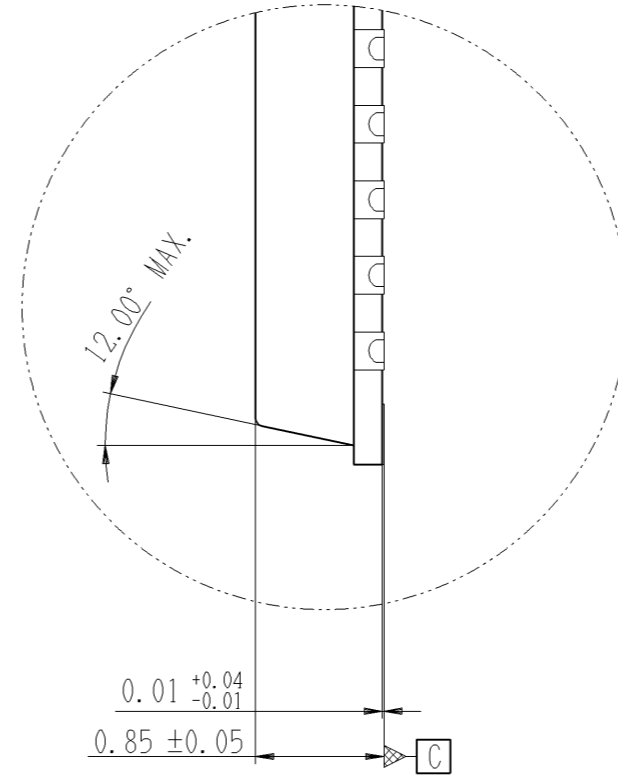
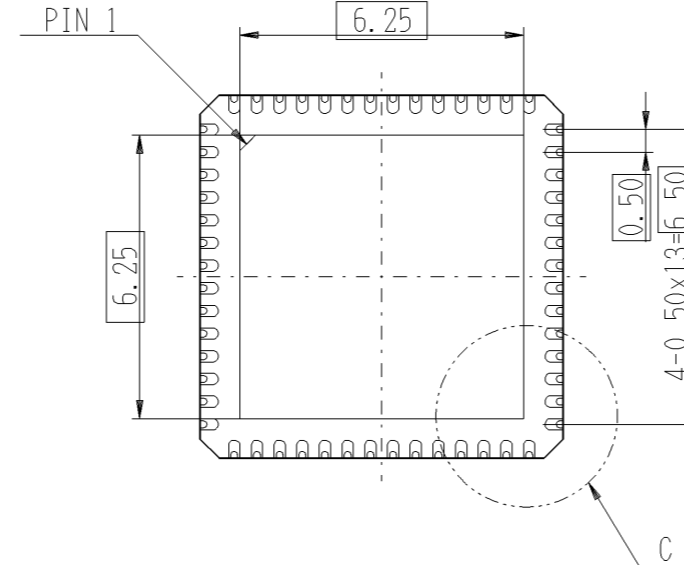
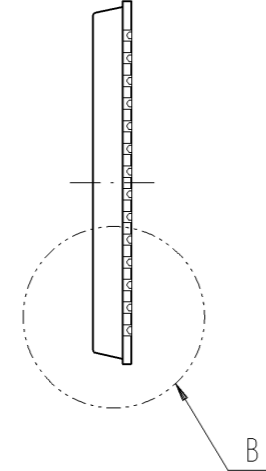
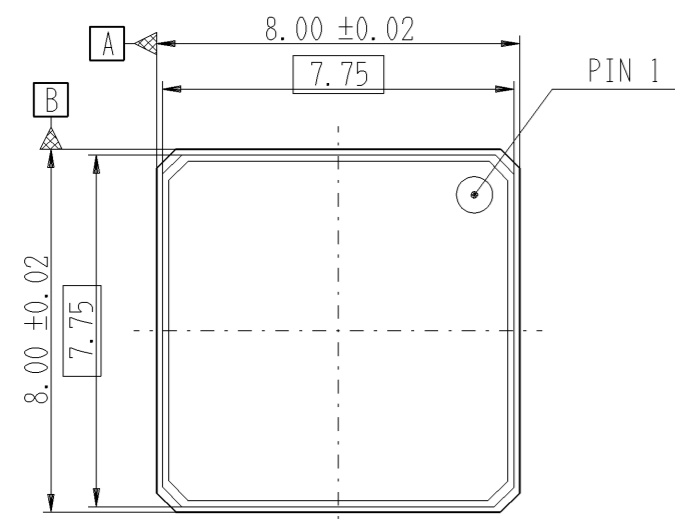
SPECIFICATION : 性能

- INSULATION RESISTANCE: 1000M ohm or more at 100V DC. 絶縁抵抗 : DC100Vで測定し1,000M ohm以上のこと。
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC for one minute. 耐電圧 : AC100Vを1分間印加して異常の無いこと。
- CONTACT RESISTANCE: 100m ohm or less with current and voltage lower than 10mA, 20mV. (initial) 接触抵抗 : 測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し100m ohm以下のこと。(初期値)
- OPERATION TEMPERATURE: 使用温度 : -40 Deg. C - +150 Deg. C
- CONTACT FORCE : Signal pin 0.392N(40gf) per pin. (approx.) 接触力 : Signal pin 0.392N(40gf) per pin. (approx.)  
Ground pin 0.490N(50gf) Ground pin 0.490N(50gf)
- OPERATION FORCE: 30.4N(3.1kgf)/34.3N Max. (3.5kgf MAX.) 操作力 : 30.4N(3.1kgf)/34.3N MAX. (3.5kgf MAX.)

発行  
15.11.26  
山一電機(株)

10	CT5173	1	BS, SUS	Ni-Au PL.
9	D13-136 #SF	4	SUS	
8	CS-778	4	SUS	
7	CS-721	4	SUS	
6	CT5058-1 -K	28	BeCu t0.18	Ni-Au PL. (CLASS BF)
5	CT5058-1 -G	28		
4	NP583-001 #CV	1	PES (GF)	BLACK
3	NP583-018 #LT	4	PEI (GF)	BLACK
2	NP583-056-018 #LB	1	PES (GF)	BLACK
1	NP583-092-001P #IN	1	PES (GF)	BLACK
部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT

TOLERANCES ±0.3 Unless otherwise specified					山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.	
尺度 SCALE 4/1 単位 UNIT mm DIMENSION 3RD. ANGLE PROJECTION	承認 APP. Y. Kato	承認 APP. K. Kumi	検図 CHK. Keith Tien	製図 DRW. Keith Tien	設計 DSGN. Keith Tien	分類 (CLASS) QFN-p0.50-56P 名称 (TITLE) NP583-056-018 図番 (DRW. NO.) A117464-001
					Sheet No. 1/2	REV. A




IC PACKAGE OUTLINE (REFERENCE DRAWING) (S=FREE)  
IC 外形参考図 (S=FREE)

DETAIL B (S=FREE)  
底部詳細図 (S=FREE)

DETAIL C (S=FREE)  
底部詳細図 (S=FREE)

発行  
'15.11.26  
山一電機(株)

TOLERANCES ±0.3 Unless otherwise specified					 山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.	
尺度 SCALE	4/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 DIMENSION	mm	Y. Kato	P15*11*19	K. Koumi	P15*11*19	P15*11*18
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION					Keith Tien	Keith Tien
分類 (CLASS) QFN-p0.50-56P 名称 (TITLE) NP583-056-018 図番 (DRW. NO.) A117464-001						Sheet No. 2/ REV. A